

04565163 **Image available**

MANUFACTURE OF PRINTED WIRING BOARD

PUB. NO.: 06-237063 [JP 6237063 A]

PUBLISHED: August 23, 1994 (19940823)

INVENTOR(s): KUSHI KENJI

IZEKI TAKAYUKI

UCHIDA HIROYUKI

APPLICANT(s): MITSUBISHI RAYON CO LTD [000603] (A Japanese Company or Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.: 05-024532 [JP 9324532]

FILED: February 12, 1993 (19930212)

INTL CLASS: [5] H05K-003/06; H05K-003/18

JAPIO CLASS: 42.1 (ELECTRONICS -- Electronic Components)

JAPIO KEYWORD: R105 (INFORMATION PROCESSING -- Ink Jet Printers)

JOURNAL: Section: E, Section No. 1634, Vol. 18, No. 617, Pg. 160,
November 24, 1994 (19941124)

ABSTRACT

PURPOSE: To solve the problem of disposal of a waste developer and to reduce considerably the time for fabricating a printed wiring board by spraying an ink onto a substrate by an ink-jet method to form an ink pattern which becomes a desired resist.

CONSTITUTION: Ink 5 is sprayed onto a copper foil 3 of a copper-plated laminar plate 1 by using an ink-jet method, thereby forming an ink pattern 6. Subsequently, the copper foil 3 not covered with the ink pattern 6 is removed by etching, after which the ink pattern 6 is peeled from the copper foil 3 of the part where it is covered with the ink pattern 6 and a wiring pattern 7 is formed. Accordingly, a photomask is not necessary and there is no developing process using an alkali water solution or an organic solvent. As a result, there is no problem of disposal of a waste developer and the time for fabricating a printed wiring board can be reduced considerably.

特開平6-237063

(43) 公開日 平成6年(1994)8月23日

(51) Int. Cl.⁵

H05K 3/06

3/18

識別記号

F 6921-4E

H 6921-4E

D 7511-4E

F I

審査請求 未請求 請求項の数 1 O L (全4頁)

(21) 出願番号 特願平5-24532

(22) 出願日 平成5年(1993)2月12日

(71) 出願人 000006035

三菱レイヨン株式会社

東京都中央区京橋2丁目3番19号

(72) 発明者 串 憲治

広島県大竹市御幸町20番1号 三菱レイヨ
ン株式会社中央研究所内

(72) 発明者 井関 隆幸

広島県大竹市御幸町20番1号 三菱レイヨ
ン株式会社中央研究所内

(72) 発明者 内田 廣幸

東京都中央区京橋二丁目3番19号 三菱レ
イヨン株式会社内

(74) 代理人 弁理士 志賀 正武 (外2名)

(54) 【発明の名称】 プリント配線板の製造方法

(57) 【要約】

【目的】 現像廃液処理の問題がなく、プリント配線板の作製所要時間を大幅に短縮することが可能なプリント配線板の製造方法の提供。

【構成】 インク5を、インクジェット方式を用いて銅張積層板1の銅箔3上に吹き付け、所望のレジストとなるインクパターン6を形成する。

